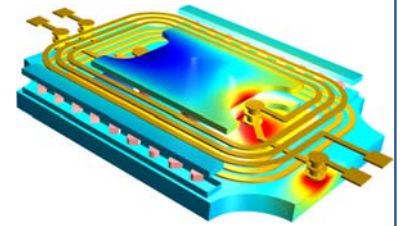


COMSOLご紹介セミナー(つくば会場)のご案内

COMSOL Multiphysics®/COMSOL Server™は、無制限な連成を可能とする有限要素法シミュレーション/モデリングソフト、およびその機能をネットワークに拡張する製品です。標準の各物理モード、偏微分方程式(PDE)モード、オプションの専門分野モジュール(電磁気学・RF・フォトニクス・構造力学・伝熱・MEMS・音響・化学反応工学・腐食・疲労解析・地質環境等)の組み合わせで、電子部品や半導体開発からバイオ/医療、環境科学等、科学全般の様々な現象の解析用として研究/開発/設計/教育等に全世界で採用されています。本セミナーでは、COMSOL製品で実現できるマルチフィジックスシミュレーションの概要と、適用事例をご紹介します。当日は個別のご相談も承ります。



プレーナトランス

多層化された薄膜コイルで構成された超小型トランスをCADからインポートして、静電容量とインダクタンスを3次元的に可視化したもの。電流による発熱を連成することも可能。

日時：2018年4月19日(木) 13:30-16:30 (受付は13:15～)

会場：つくば研究支援センター 1F 研修室3

住所：〒305-0047 茨城県つくば市千現2-1-6

電話番号：029-858-6000

駐車場：施設無料駐車場あり (お申し込み時にその旨ご指定ください)

セミナー講師：弊社スタッフ

タイムテーブル：(※講義内容は都合により変更となる場合があります)

13:15-13:30 受付

13:30-14:30 COMSOL製品で実現できる世界

～真のマルチフィジックスの世界へようこそ！～

14:30-14:45 休憩

14:45-16:15 COMSOL製品の適用事例のご紹介

16:15-16:30 質疑応答及びフリーディスカッション

定員：20名 (定員に達した際には締切となります)

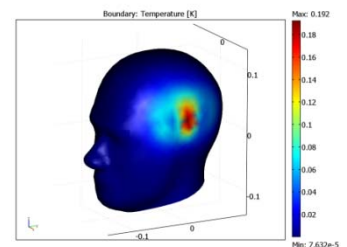
参加費：無料

【問合せ：申込み先】計測エンジニアリングシステム(株) マーケティング部セミナー担当

Tel: 03-5282-7040・Fax: 03-5282-0808・E-mail: training-sp@kesco.co.jp

お申し込みページ:

http://www.kesco.co.jp/comsol_intro.html



携帯電話による人体頭部の加熱

高周波加熱による人体頭部の温度上昇と共に、表皮の血流による放熱を3次元的に連成したシミュレーション。生体材料のシミュレーションが可能であり、さらに単純なファントムによる実験と異なり、人体頭部の内部構造や血流の影響を考慮できる。

◆◆◆COMSOLご紹介セミナー(つくば会場・4月19日(木)開催) 参加申込書 ◆◆◆

会社名			
住所			
TEL		FAX	
氏名		E-mail	
所属 役職	駐車場 必要 ・ 不要 (いずれかに○印)		

Faxでのお申し込み: 03-5282-0808 計測エンジニアリングシステム マーケティング部 宛て